

2016 中日电子电路秋季大会暨秋季国际 PCB 技术/信息论坛日程安排

11月2日					
下午	时间	四楼 国际宴会厅 论坛开幕特邀演讲 主持人：黄志东			
	场次				
	13:30-13:45	论坛开幕式 CPCA 理事长由镭致辞、JPCA 代表致辞			
	13:45-14:30	特别演讲 由镭理事长·中国印制电路行业协会			
	14:30-15:30	特别演讲 岩城庆太郎副会长·一般社団法人日本电子回路工业会			
	15:30-16:15	特别演讲 左志成理事长·中国电子劳动学会			
	16:15-17:00	大数据和分析生产 黄笑珍资深工程项目经理·IBM			
17:00 开始	参观广东正业科技股份有限公司及招待晚餐（名额限定前 100 名，请提前在报名表内报名。）				
11月3日					
上午	时间	四楼 2 号会议室 印制电路设计	四楼 5 号会议室 图形	四楼 7 号会议室 挠性和刚挠性印制板技术	四楼 8 号会议室 管理与其他
	场次				
	09:30-09:55	CAM 数据与 ERP 的无缝链接 张豪·博敏电子股份有限公司	一种适用于大孔及高度密集孔 PCB 板塞孔树脂的研制 丁杰·深圳市板明科技有限公司	应用于手机摄像头的刚挠结合板制作工艺 叶锦群·胜宏科技（惠州）股份有限公司	基于 RF 射频的无线数据采集方法研究 陈锐·汕头超声印制板公司
	09:55-10:20	一款基于 HFSS 手机传输线缆设计 陆平·深南电路股份有限公司	一种优于超粗化的干湿膜前处理方法 钟汝泉·深圳市瑞世兴科技有限公司	电镀铜对挠性板弯折性能的影响研究 李冲·广州兴森快捷电路科技股份有限公司/深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	清洁生产——做好过程节水管理 陈鹏宇·天津普林电路股份有限公司
	10:20-10:45	高速 PCB 差分过孔研究 刘文敏·广州兴森快捷电路科技股份有限公司/深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	光热固化程度对阻焊附着力的影响 周波等·广州兴森快捷电路科技股份有限公司/深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	带金手指设计的刚挠结合板尺寸偏移改善 宋林鹏等·深圳市金百泽电子科技股份有限公司/惠州市金百泽电路科技股份有限公司	雕刻设备在 PCB 可追溯性系统中的应用研究 巩杰·广合科技（广州）有限公司
	10:45-11:10	高速信号系统性研究——铜厚、线宽、铜箔粗糙度的影响 李民善·生益电子股份有限公司	38 μm/38 μm 精细线路制作 陈娟·广州兴森快捷电路科技股份有限公司/深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	等离子体清洗在刚挠结合板加工中的应用 程骄·广东东硕科技有限公司/广东光华科技股份有限公司	三嗪硫醇对覆铜板性能的影响 孟运东·广东生益科技股份有限公司
	11:10-11:35	印制电路板铜面处理工艺对高频信号传输的影响研究 陈苑明·电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室/珠海方正印刷电路板发展有限公司	聚集性板面脏污形成机理与改善研究 唐昌胜等·深南电路股份有限公司	刚挠结合板弯折解决方案研究 张河根·深南电路股份有限公司	全员精细化节能管理应用与实践 闵秀红·深南电路股份有限公司
	11:35-12:00	高速 PCB 阻抗一致性研究 程柳军·广州兴森快捷电路科技股份有限公司/深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	不同底铜碱性蚀刻动态补偿系数研究 张军·景旺电子科技（龙川）有限公司	不流动/低流动半固化片流胶量控制优化的研究 李文冠·深圳市景旺电子股份有限公司	铜浆塞孔工艺研究 冷科·深南电路股份有限公司
12:00-13:30	午餐				

11月3日

时间 场次	四楼 5号会议室 层压与其他	四楼 7号会议室 电镀与涂覆	四楼 8号会议室 特种印制板制造技术
	13:30-13:55	HDI 板压合板边四周缺胶原因分析与研究 钟皓·同健(惠阳)电子有限公司	对流和整平剂协同对PCB通孔深镀能力的影响研究 王翀·电子科技大学微电子与固体电子学院/广东光华科技股份有限公司
13:55-14:20	高频印制电路铜面平整化修饰技术的研究 文娜·电子科技大学/江苏博敏电子有限公司/博敏电子股份有限公司	高密度互连通孔填孔电镀铜工艺研究 陈苑明·电子科技大学微电子与固体电子学院/广东光华科技股份有限公司	浅谈内埋电容 PCB 板的加工 郝玉娟·广州兴森快捷电路科技有限公司/深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
14:20-14:45	压合条件对层偏的影响量化研究 金文雄·广合科技(广州)有限公司	乙醛酸活化铜线路实现无钯 ENIG 的可行性研究 林建辉·电子科技大学微电子与固体电子学院	应用于厚型气体电子倍增器的高耐压 PCB 研究 吴军权·惠州市金百泽电路科技有限公司/中国科学院高能物理研究所
14:45-15:10	不流动型半固化片性能对刚挠结合板可靠性影响分析 林楚涛·广州兴森快捷电路科技有限公司/深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	选择性局部电镍厚金板工程流程设计的探讨 赖长连·深圳崇达多层线路板有限公司	覆盖膜保护方式内置元器件 PCB 制作技术研究 林启恒·惠州市金百泽电路科技有限公司/深圳市金百泽电子科技股份有限公司
15:10-15:35	LDI 在生产工控类 HDI 产品中的成本优势分析 董猛·深圳崇达多层线路板有限公司	以 M-SAP 为中心的形成微细线路的表面处理工艺 任骁鹏·MELTEX 株式会社 (MELTEX INC.)	PTFE 板材制作可靠性研究 万里鹏·生益电子股份有限公司
15:35-16:00	外形加工尺寸变化研究 林飞·深南电路股份有限公司	沉银板银层下界面空洞关键影响因素的研究 鲁志强·广州兴森快捷电路科技有限公司/深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	离子注入技术应用于 PCB 行业的研究 黄得俊·珠海方正科技高密电子有限公司
16:00-16:25	高厚径比微型孔对接钻加工方法探究 柴超·深南电路股份有限公司	等离子体咬蚀速率影响因素的研究 曹大福·生益电子股份有限公司	功率模块-小型化集成化解决方案-埋入元器件基板技术 黄立湘·深南电路股份有限公司

下午

*具体演讲安排以论坛会当天为准